

# Cuボールを芯材とするはんだ付け材料

Soldering Material Using Copper Ball Cores

## 高精度なスペースを要求されるPOPや3Dの実装に

Suitable for POP and 3D Mounting Requiring High Spatial Precision

### Cuボールにはんだめっきを施した Sparkle Ball C

#### 特長

- 溶融しないCuが、基板間のスペースを一定・高精度に保ちます。
- 溶融しないCuは、未溶融を防止し優れた接続安定を実現します。
- 溶融しないCuは、良好な熱伝導・電気伝導をお約束します。

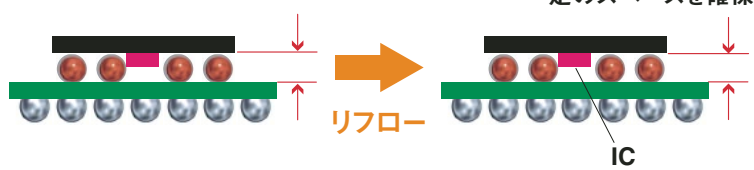


#### 製品仕様

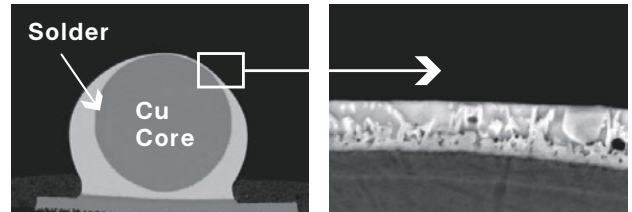
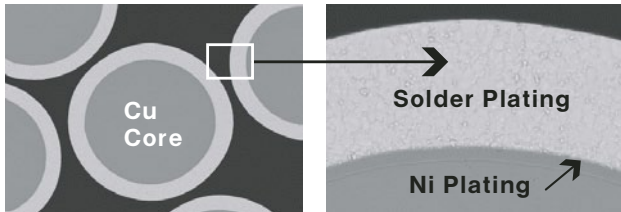
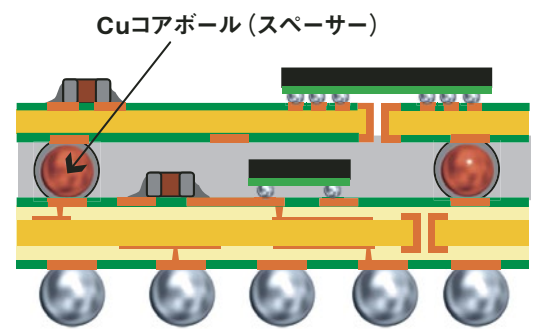
##### □ はんだボールを用いたPOP実装



##### □ Sparkle Ball C を用いたPOP実装



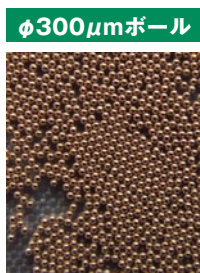
##### □ 3D実装への応用例



### 狭公差・高真球度Cuボール Sparkle Ball HT Cu

#### 特長

- 培われたはんだボール形成技術により、狭公差・高真球度Cuボールを実現。
- 各種ボールサイズを準備、いろいろな用途に応用可能。



##### □ 60μmCuボールの球形分布 60±0.5μmに100%分布

